川崎製鉄技報
24 (1992) 2, 152-154

高熱伝導性AlN基板と[redacted]*1

熊谷 正人*2　前田 榮造*3　小笠原 一紀*4

High Thermal Conductivity AlN Substrate and Its Metallized Products

Masato Kumagai, Eizo Maeda, Kazuki Ogasawara

1 はじめに

電子機器の高速化，小型・軽量化，高信頼性化への要求が高まり

Table 1 Properties of developed AlN substrate

Table 2 Characteristics of Cu-bonded AlN substrate